## 深圳市科思科技股份有限公司 关于公司研发进展的自愿性披露公告

本公司董事会及除刘建德先生外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司深圳高芯思 通科技有限公司(以下简称"高芯思通")研发的射频收发芯片已完成试产流片 工作,并完成基本的功能、性能的测试工作,该研发项目取得阶段性成果。后续 高芯思通将继续推进芯片功能、性能的全面测试工作。

## 芯片研发情况

公司研发的射频收发芯片已完成试产流片工作,并完成基本的功能、性能的 测试工作,后续高芯思通将继续推进芯片功能、性能的全面测试工作。该型芯片 设计应用领域为公专网和自组网通信、无人装备通信、应急通信和其他各类特种 行业数据链以及无线感知应用领域,凭借其灵活架构和突破性功能技术指标,深 度赋能软件无线电、认知无线电、动态频谱接入(DSA)和通感一体等先进无线 通信应用的创新与部署。

## 对公司的影响

公司成功完成射频收发芯片的试产流片工作,并完成基本的功能、性能的测 试工作,该型芯片在关键技术方面实现明显突破。在系统功能配置上,对用户场 景下的系统设计也更为全面且友好。在确保射频性能的同时,赋能用户更加敏捷 地开发新型无线应用方案。该型芯片可与公司自主研制的智能无线电基带处理芯 片搭配使用,形成一套具有竞争力的完整解决方案开发平台,进一步满足客户需求,拓展公司的产品布局,提升公司核心竞争力。

## 三、风险提示

公司自研的射频收发芯片尚未完成测试工作,未形成量产,不会对公司当期业绩产生重大影响,对公司未来业绩影响程度尚无法准确预测。

该型芯片尚处于市场导入初期,尚未实现规模化销售。未来的市场需求、市场拓展及销售情况尚具有不确定性,存在商品销售不及预期的风险。

公司将持续跟进后续进展,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会 2025年11月18日